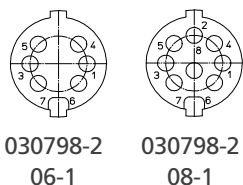


Leiterplattenlayouts siehe Seite 3.63
Printed circuit board layouts see page 3.63
Modèles des cartes imprimées voir à la page 3.63

Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder



030798-2

SWUM™-Einbaukupplung nach IEC 61076-2-106 und AISG-Spezifikation, IP 68/67, mit Schraubverschluss und Massekontakt, für Leiterplatten, manuelle Lötung, für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA, V2 nach UL 94
Kontaktbuchse	CuZn, versilbert und flashvergoldet, im Lötbereich verzinkt
Massekontakt	CuZn, unternickelt und verzinkt
Gehäuse	Zn-Druckguss, vernickelt
Ringmutter	CuZn, vernickelt
Dichtung	NBR
3. Mechanische Daten	
Steckkraft/Kontakt ¹	≤ 5,0 N
Ziehkraft/Kontakt ¹	≥ 1,2 N
Kontaktierung mit	Steckern 033..., 0365
	Steckern nach IEC 61076-2-106 und IEC 60130-9
Schutzart ²	IP 68/67
4. Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom	5 A
Bemessungsspannung ³	60 V AC
Isolierstoffgruppe ³	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 350)
Prüfspannung	1 kV/60 s
Isolationswiderstand	> 10 GΩ

¹ gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
² nach IEC 60529/DIN EN 60529
IP 68: dicht in verschraubtem Zustand; mit einem zugehörigen Gegenstück verschraubte Steckverbindung ist gegen Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit geschützt
IP 67: dicht in ungestecktem Zustand (SWUM™); durch einen versehentlich ungeschützten ungesteckten Steckverbinder können Staub oder Feuchtigkeit nicht in das Geräteinnere eindringen
³ IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI für UL nach ANSI/UL 746 A

*a Mutter lose beigelegt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément

*b Lötstift
solder pin
plot à souder

*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage

*d O-Ring-Dichtung
O-ring gasket
anneau torique d'étanchéité

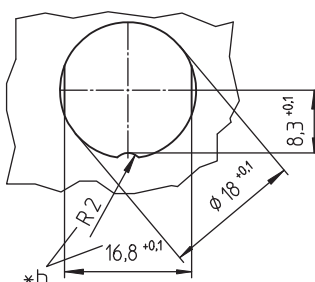
*e Massekontakt
ground contact
contact pour mise à terre

*f Flachdichtung
flat gasket
joint d'étanchéité plat

*g Einbauöffnung
port
ouverture d'emplacement

*h Verdreherschutz, Ausführung wahlweise
anti-rotation, alternative execution
protection antitorsion, exécution alternative

*g



SWUM™-Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 61076-2-106 und AISG-Spezifikation, IP 68
SWUM™ circular connectors with threaded joint acc. to IEC 61076-2-106 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires SWUM™ avec verrouillage à vis suivant CEI 61076-2-106 et spécification AISG, IP 68

030798-2

SWUM™ chassis socket acc. to IEC 61076-2-106 and AISG specification, IP 68/67, with threaded joint and ground contact, for printed circuit boards, manual soldering, for rear mounting

1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Body	PA, V2 according to UL 94
Contact bush	CuZn, silvered and flash gilded tinned in solder area
Ground contact	CuZn, pre-nickelated and tinned
Housing	Zn diecast, nickelated
Ring nut	CuZn, nickelated
Gasket	NBR
3. Mechanical data	
Insertion force/contact ¹	≤ 5,0 N
Withdrawal force/contact ¹	≥ 1,2 N
Mating with	plugs 033..., 0365 plugs according to IEC 61076-2-106 and IEC 60130-9
Protection ²	IP 68/67

4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C)

Contact resistance	≤ 5 mΩ
Rated current	5 A
Rated voltage ³	60 V AC
Material group ³	IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 350)
Test voltage	1 kV/60 s
Insulation resistance	> 10 GΩ

¹ measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
² according to IEC 60529/DIN EN 60529

IP 68: sealed in locked position; pair of appropriate connectors in locked position is sealed against ingress of dust and moisture
 IP 67: sealed when unmated (SWUM™); no dust or moisture can ingress into the inside of the device through an unmated connector accidentally left unprotected

³ IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer according to IEC 60664/DIN EN 60664, CTI for UL acc. to ANSI/UL 746 A

030798-2

Embase femelle SWUM™ suivant CEI 61076-2-106 et spécification AISG, IP 68/67, avec verrouillage à vis et contact pour mise à terre, pour cartes imprimées, soudage manuel, pour montage par derrière

1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA, V2 suivant UL 94
Prise de contact	CuZn, argenté et doré flash, étamé à la partie à souder
Contact pour mise à terre	CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier	Zn moulé sous pression, nickelé
Écrou à anneau	CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	NBR
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion/contact ¹	≤ 5,0 N
Force de séparation/contact ¹	≥ 1,2 N
Raccordement avec	connecteurs mâles 033..., 0365 connecteurs mâles suivant CEI 61076-2-106 et CEI 60130-9
Protection ²	IP 68/67

4. Caractéristiques électriques (à T_{amb} 20 °C)

Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Courant assigné	5 A
Tension assignée ²	60 V AC
Groupe de matériau ²	IIIa (CEI)/2 (UL) (CTI ≥ 350)
Tension d'essai	1 kV/60 s
Résistance d'isolement	> 10 GΩ

¹ mesurée avec une tige d'acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
² suivant CEI 60529/DIN EN 60529

IP 68: étanche à l'état verrouillé; un pair de connecteurs appropriés à l'état verrouillé est protégé contre la poussière et l'humidité
 IP 67: étanche à l'état non enfiché (SWUM™); ni poussière ni humidité ne peuvent entrer dans l'appareil au travers d'un connecteur non enfiché et non protégé par négligence

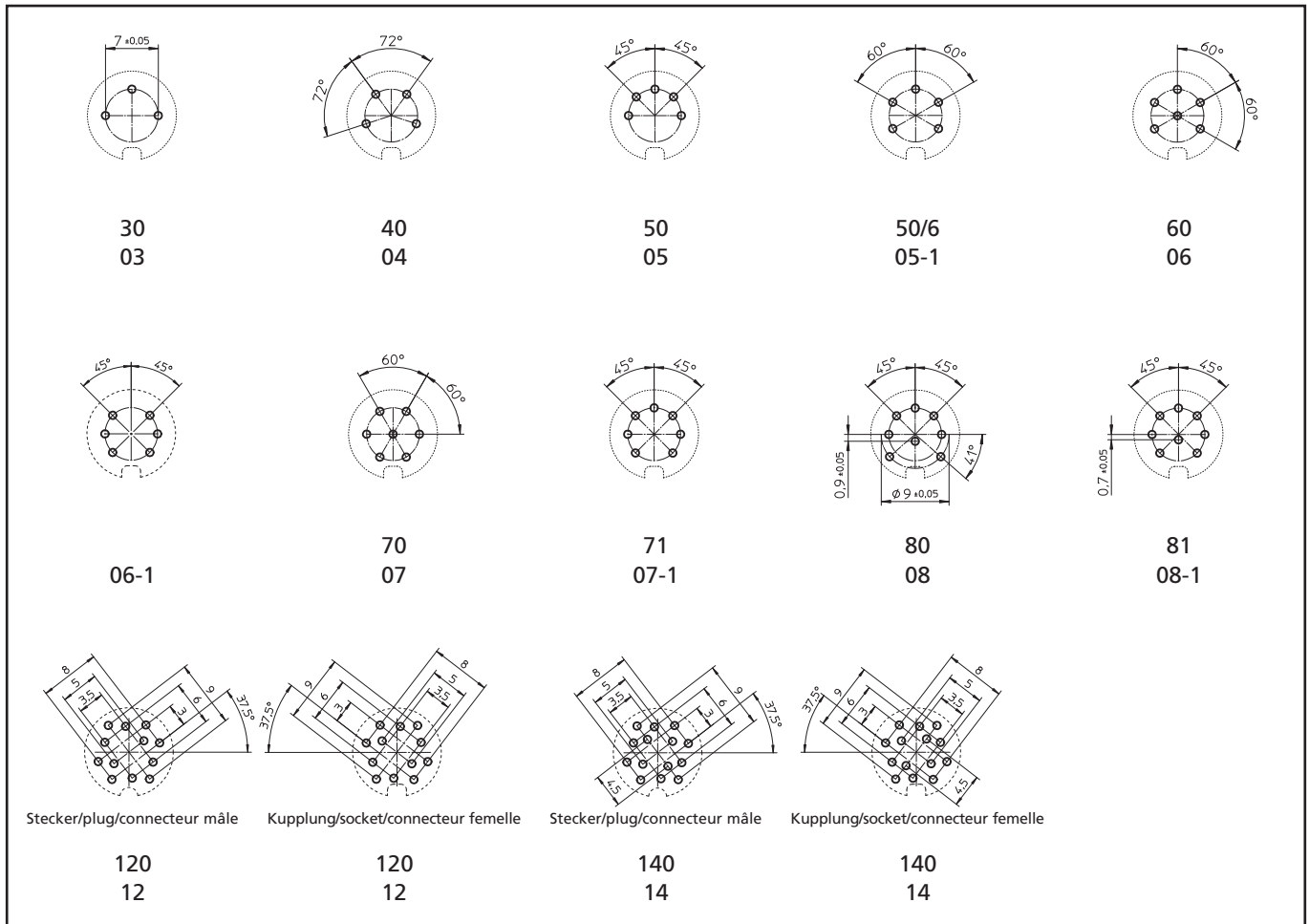
³ exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant suivant CEI 60664/DIN EN 60664, CTI pour UL suivant ANSI/UL 746 A

SWUM™

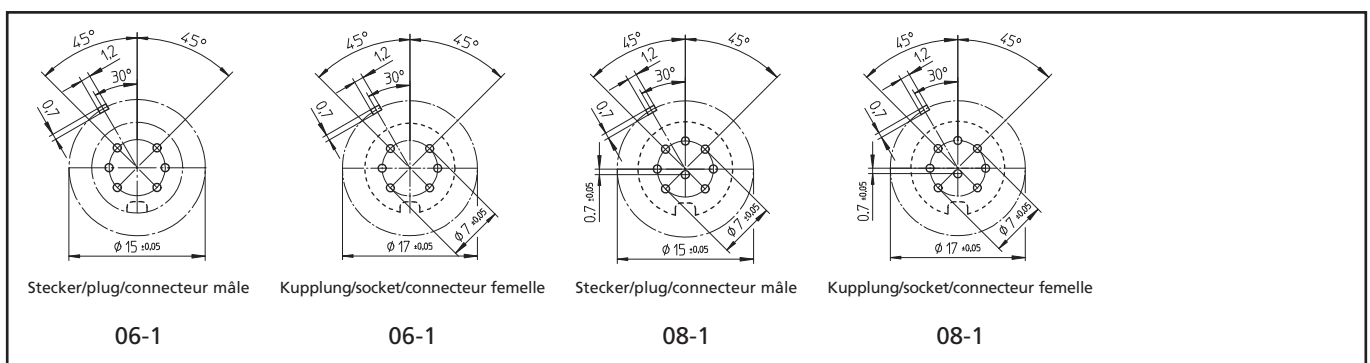
Dicht im ungesteckten Zustand
Sealed When UnMated
Étanche à l'état non enfiché

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	
030798-2 06-1	6	50	
030798-2 08-1	8	50	

Verpackung: im Karton
 Packaging: in a cardboard box
 Emballage: dans un carton



Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder, von der Bestückungsseite gesehen
Printed circuit board layouts for chassis connectors, components side view
Modèles de cartes imprimées pour embases, vus du côté à équiper



Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder mit Massekontakt, von der Bestückungsseite gesehen
Printed circuit board layouts for chassis connectors with ground contact, components side view
Modèles de cartes imprimées pour embases avec contact de masse, vus du côté à équiper